京都府中小企業技術センター　応用技術課　電気通信係　宛

　（jisso@kptc.jp 又は FAX 075－315－9497）

**令和７年度 京都実装技術研究会 第２回例会 申込書**

「半導体パッケージングの最新動向」(１０/１７)

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |
| 所在地 |  |
| 連絡担当者 | 所属・役職 |  |
| 氏名 |  |
| E-ｍail |  |
| 電話番号 |  |
| 参加方法 | □ 会場　　□ Web　　□ 連絡のみ担当（本人は不参加） |
| 懇親会 |  □ 参加　　□ 不参加 |
| 参加者 | 所属・役職 | 氏名 | E-mail※個別連絡も希望する場合は記入 | 参加方法 | 懇親会 |
|  |  |  | □ 会場□ Web | □ 参加□ 不参加 |
|  |  |  | □ 会場□ Web | □ 参加□ 不参加 |
|  |  |  | □ 会場□ Web | □ 参加□ 不参加 |
|  |  |  | □ 会場□ Web | □ 参加□ 不参加 |
| 備考 |  |

**※懇親会へのご参加を希望される場合は １０/９（木）までにお申込みください。**

　（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります）

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

・Web参加は、原則1事業所1接続でお願いします。多人数で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。

・録画、録音等の配信データの記録，保存は一切禁止です。

・発熱等の症状がある方は、ご来場をお控えください。